

北京赛微电子股份有限公司

关于控股子公司 MEMS 温湿度传感器通过验证并启动试产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱克斯北京”）代工制造的某款 MEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写，即微电子机械系统，简称为微机电系统）温湿度传感器通过了客户验证，赛莱克斯北京收到该客户发出的采购订单，启动首批 MEMS 温湿度传感器 8 英寸晶圆的小批量试生产。

MEMS 温湿度传感器是一种基于微机电系统技术的传感器，其原理是利用微小的机械结构和电子元件来感知和测量周围环境的温度和湿度。MEMS 温湿度传感器芯片集成了温度敏感元件、湿度敏感元件、A/D 转换单元、信号处理单元等功能，可将外界的温度和湿度转化为电信号，通过转换单元输出特定的数字信号，具有高精度、高稳定性、高信噪比等特点。MEMS 温湿度传感器基于 MEMS 工艺技术制造，具有体积小、重量轻、能耗低等特点，可广泛应用于智能家电、汽车、手机以及工业、农业、医疗等方面。

近年来，赛莱克斯北京持续加大研发投入，自主积累基础工艺，积极探索各类 MEMS 器件的生产诀窍，努力为全球通信、生物医药、工业汽车、消费电子等各领域客户，尤其是中国本土客户提供优质的 MEMS 工艺开发及晶圆制造服务，积极推动公司在本土形成和提升自主可控的 MEMS 生产制造能力，加速国产替代。

根据产业发展规律及公司境内外产线的实际运营经验，不同类别 MEMS 芯片一般都需要经历从工艺开发到风险试产、规模量产的过程，所耗时间存在差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2024年10月9日